

芯联集成电路制造股份有限公司**2023年度业绩快报公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2023年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023年年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	532,448.12	460,633.77	15.59
营业利润	-294,212.62	-159,552.58	不适用
利润总额	-294,142.28	-159,502.14	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-196,746.25	-108,843.26	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-225,837.31	-140,305.32	不适用
研发费用	154,107.62	83,904.95	83.67
经营活动产生的现金流量净额	273,036.01	133,428.17	104.63
EBITDA (息税折旧摊销前利润)	94,440.39	80,974.18	16.63
基本每股收益(元)	-0.32	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率	-22.56%	-27.48%	增加 4.92 个百分点

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,158,510.94	2,586,309.66	22.12
归属于母公司的 所有者权益	1,246,859.92	344,376.39	262.06
股本	704,460.23	507,600.00	38.78
归属于母公司所有者的 每股净资产(元)	1.77	0.68	160.89

注：

1、财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。根据该准则解释的衔接规定，公司按照规定对本报告期初相关报表项目进行了调整。

2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。

3、表格中的数据尾差为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期的经营情况、财务情况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内，预计公司实现营业总收入 532,448.12 万元，同比增长 15.59%，其中主营业务收入同比增长 24.06%；归属于母公司所有者的净利润为 -196,746.25 万元，同比增亏 80.76%；归属于母公司所有者的扣除非经营性损益的净利润为 -225,837.31 万元，同比增亏 60.96%；基本每股收益为 -0.32 元，同比减少 51.24%。

报告期末，预计公司总资产为 3,158,510.94 万元，同比增长 22.12%；归属于母公司的所有者权益为 1,246,859.92 万元，同比增长 262.06%；归属于母公司所有者的每股净资产为 1.77 元，同比增长 160.89%。

2、影响经营业绩的主要因素

(1) 主营业务的影响：报告期内，随着全球新能源汽车市场的持续繁荣以及国产替代需求的提升，公司在高端车载产品领域采取“技术+市场”双重保障机制，促使公司整体收入的高速增长和经营性净现金流的大幅提升。截至报告期末，公司拥有了种类完整、技术先进的高质量功率半导体研发及量产平台，是国内规模最大的 MEMS 传感器芯片、车规级 IGBT 芯片、SiC MOSFET 芯片及模组封测等的代工企业。

(2) 研发投入的影响：报告期内，为保证产品具有国际竞争力，公司持续在 8 英寸功率半导体、MEMS、连接等方向增加研发投入，同时公司大幅增加了对 SiC MOSFET、12 英寸产品方向的研究力度。预计 2023 年研发支出约 15.41 亿元，研发投入约占营业总收入的 28.94%，同比增加约 7.02 亿元，同比增长约 83.67%。2023 年，公司共提出知识产权申请 295 项，获得专利 102 项。上述新研发项目和知识产权积累为公司未来的发展和收入增长奠定了基础。

(3) 扩产项目影响：报告期内，公司在 12 英寸产线、SiC MOSFET 产线、模组封测产线等方面进行了大量的战略规划和项目布局。2023 年度公司为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约为 101.00 亿元，报告期内，公司预计产生的折旧及摊销费用约为 33.75 亿元，较上年增加约 12.93 亿元。上述事项的前期费用和固定成本等，对公司报告期内的经营业绩产生了较大影响。剔除折旧及摊销等因素的影响，公司 2023 年 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为 9.44 亿元，与上年同期相比增加约 1.35 亿元，同比增长约 16.63%。随着新

增产能的逐步释放，收入水平的快速提升，规模效应逐步显现，以及折旧的逐步消化，公司在业务布局、技术的领先性以及产品结构等方向的优势将逐渐显现，盈利能力将得到快速改善。

面向未来，公司持续看好汽车电动化、智能化进程，随着新产品、新应用、新客户的拓展，预计公司车规级产品营业收入将持续增加，特别是 SiC MOSFET 上车速度与数量将快速提升，公司最新一代的 SiC MOSFET 产品性能已达世界领先水平，正在建设的国内第一条 8 英寸 SiC 器件研发产线将于 2024 年通线，同时与多家新能源汽车主机厂签订合作协议，2024 年 SiC 业务营收预计将超过 10 亿元，继续巩固公司在国内车规级芯片代工与模组封测领域的领先地位。

公司已经完整搭建了覆盖车载、工控、消费类的驱动、电源和信号链多个平台，客户群广泛覆盖国内外领先的芯片和系统设计公司。随着公司产品研发创新以及 SiC MOSFET 产线、12 英寸产线、以及模组封测产线产能的不断释放，将持续不断地提升对公司 2024 年营业收入的贡献。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达到 30% 以上的主要原因说明

1、报告期内公司归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产分别同比增加 262.06%、38.78%、160.89%，主要系报告期内公司公开发行股票并在科创板上市，股本及股本溢价增加，归属于母公司所有者权益增加。

2、报告期内公司研发费用同比增加 83.67%，主要系报告期内公司为保证产品具有国际竞争力，持续在 8 英寸功率半导体、MEMS、连接等方向增加研发投入，同时大幅增加了 SiC MOSFET、12 英寸产品方向的研发力度，研发费用增加。

3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 104.63%，主要系报告期内公司销售规模扩大、销售商品回款增加及收到的税费返还增加。

三、风险提示

本公告所载公司 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日